산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	**보 도 자 료**	대한민국 대전환 한국판뉴딜

2021년 12월 8일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 12.7일(화) 15시 30분 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 12. 7(화)	담당부서	반도체디스플레이과
담당과장	박찬기 과장(044-203-4270)	담 당 자	전영우 사무관(044-203-4276)

산업부 장관, 시스템반도체 첨단패키징 공장 준공식 참석

- 2,200억원 규모의 첨단 반도체 패키징 투자현장 방문 -

□ **산업통상자원부**(이하 '산업부') 문승욱 장관은 '21.12.7일(화) 15시 30분 충북 괴산 첨단산업단지에서 개최된 "네패스라웨 청안캠퍼스 준공식"에 참석하였다.

○ 이 자리에는 이시종 충북도지사를 비롯해 반도체업계 관계자 등이 참석하였으며, 코로나19 상황을 고려하여 참석인원을 최소화하는 등 방역수칙을 철저히 준수하여 행사를 진행하였다.

< 행 사 개 요 >

- **(일시/장소)** 2021. 12. 7(화) 15:30~16:30 / 네패스라웨 청안캠퍼스(충북 괴산)
- **(참 석 자)** 문승욱 산업부 장관, 이병구 네패스 회장, 이시종 충청북도 도지사, 이차영 괴산군수, 반도체업계 관계자 등 70여명
- **(행사내용)** 네패스 소개(영상), 기념식, 테이프커팅 진행

□ 금일 방문한 청안캠퍼스는 시스템반도체 패키징기업인 네패스라웨(네패스 자회사)가 2,200억원을 투자한 **세계 최초 600mm PLP 양산팹**으로,

* PLP(Panel Level Package): 웨이퍼를 자른 칩(die)을 사각형 모양의 패널에 배치후 한꺼번에 패키징하여 효율향상, 네패스가 최초로 대면적인 600mm 공정개발

○ 기존 WLP 방식대비 5배의 반도체 칩을 한꺼번에 생산할 수 있는 첨단 패키징 기술이 적용되어 **생산효율성 및 가격경쟁력을 확보**하였다.

* WLP(Wafer Level Package): 웨이퍼를 칩단위로 자르지 않고 패키징(최대 300mm)

□ **문승욱 장관은** 빠르게 발전하고 있는 **첨단 패키징 기술의 중요성**을 강조하면서, 네패스라웨 첨단 패키징 공장 준공을 축하하였고,

○ 네패스의 첨단패키징 기술은 국내 디스플레이 소부장 기업과 함께 **대면적 LCD 터치패널을 양산한 경험을 바탕으로** 개발되었고 이는 산업간 협력이 가져온 **대표적인 기술혁신 사례**라 소개하였다.

□ 문 장관은 앞으로도 우리 패키징 산업이 눈부신 성과를 낼 수 있도록 **정부도 지원을 아끼지 않겠다**고 강조하면서,

○ 지난 5월 「K-반도체 전략」에서 발표한 **첨단 패키징 플랫폼 대규모 예타 사업**을 올해 추진하겠다고 밝혔다.

* 시스템반도체 첨단 패키징 플랫폼 구축사업('23~'29년, '21.4분기 예타신청)

○ 또한, **패키징 전문인력양성 사업**의 내년도 **예산을 올해 대비 50% 증액**하는 등 전문인력 확충에 대한 계획도 언급하였다.

* 반도체소재부품장비기술인력양성사업 內 후공정분과('21년 16억원 → '22년 24억원)

○ 마지막으로 패키징 산·학·연의 의견을 모아 패키징 산업의 저변확대를 위한 **종합적인 대책**을 내년 상반기 중에 마련하겠다고 밝혔다.

【붙임】 네패스라웨 청안캠퍼스 신규 Fab 준공식 개요

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 전영우 사무관(☎ 044-203-4276)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 **네패스라웨 청안캠퍼스 신규 Fab 준공식 개요**

1. 개최배경

□ 네패스 그룹은 지난 5월 「K-반도체전략보고」시 **향후 5년간 1조원 이상의 투자**를 발표하는 등 **국내 패키지 산업을 선도 중**

□ **네패스라웨**는 **충북 괴산첨단산단 內 첨단 패키징 신규 Fab을 완공**하여, 이를 기념하기 위한 준공식 개최

< 네패스라웨 괴산 신규Fab 투자 개요 >

◇ 투자비용 : 2,200억원(Fab 구축비용 700억 포함)
◇ 팹 규모 : 총 5,247평 (클린룸 2,800평) 규모
◇ 기대효과 :
❶ 독자기술인 600mm FO-PLP 대규모 양산으로 대만 패키징 기업 상대로 우위 선점 가능
❷ 지역(충북 괴산군) 일자리 창출 및 지역 경제 활성화에 기여(총 450명 고용계획)



2. 행사개요

□ (**일시/장소**) 12.7(화) 15:30~16:30 / 네패스라웨 청안캠퍼스(충북 괴산)

□ (**참석자**) 문승욱 산업부 장관, 이병구 네패스 회장, 이시종 충북도지사, 이차영 괴산군수, 반도체 업계 관계자 등 70여명

□ (**세부계획안**)

시간		내용	비고
15:30~15:43	(13`)	▪ 오프닝공연, 개회, 내빈소개, 국민의례	사회자
15:43~15:48	(5`)	▪ 네패스 소개 및 준공 영상	
15:48~15:51	(3`)	▪ 기념사	네패스 회장
15:51~16:06	(15`)	▪ 축사	장관, 충북도지사, 괴산군수 외1명
16:06~16:09	(3`)	▪ PLP패널 서명 및 기념촬영	장관, 네패스 회장
16:09~16:21	(12`)	▪ 축하 공연	
16:21~16:23	(2`)	▪ 행사 마무리	
16:23~16:26	(3`)	▪ 이동	
16:26~16:30	(4')	▪ 테이프 커팅 및 기념촬영	장관 외 10명